

PCB天线标签RFID线路板生益S1000-2沉金板

产品名称	PCB天线标签RFID线路板生益S1000-2沉金板
公司名称	深圳市捷科电路有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产周期:8天 生产厂家:捷科的 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新二社区庄村二路17号金源印刷1栋厂房2层南
联系电话	0755-27718513-802 18813674554

产品详情

PCB天线标签RFID线路板生益S1000-2沉金板

零组件布局是实现一个优异RF设计的关键，最有效的技术是首先固定位于RF路径上的零组件，并调整其方位，使RF路径的长度减到最小。并使RF输入远离RF输出，并尽可能远离高功率电路和低噪音电路。

最有效的电路板堆栈方法是将主接地安排在表层下的第二层，并尽可能将RF线走在表层上。将RF路径上的过孔尺寸减到最小不仅可以减少路径电感，而且还可以减少主接地上的虚焊点，并可减少RF能量泄漏到层叠板内其它区域的机会。

在实体空间上，像多级放大器这样的线性电路通常足以将多个RF区之间相互隔离开来，但是双工器、混频器和中频放大器总是有多个RF/IF信号相互干扰，因此必须小心地将这一影响减到最小。RF与IF走线应尽可能走十字交叉，并尽可能在它们之间隔一块接地面积。正确的RF路径对整块PCB板的性能而言非常重要，这也就是为什么零组件布局通常在移动电话PCB板设计中占大部份时间的原因。

在移动电话PCB板上，通常可以将低噪音放大器电路放在PCB打样板的某一面，而高功率放大器放在另一面，并最终藉由双工器在同一面上将它们连接到RF天线的一端和基频处理器的另一端。这需要一些技巧来确保RF能量不会藉由过孔，从板的一面传递到另一面，常用的技术是在两面都使用盲孔。可以藉由将盲孔安排在PCB板两面都不受RF干扰的区域，来将过孔的不利影响减到最小。